

ミリ波用低雑音増幅器の寄生相互インダク タンスの影響の検討

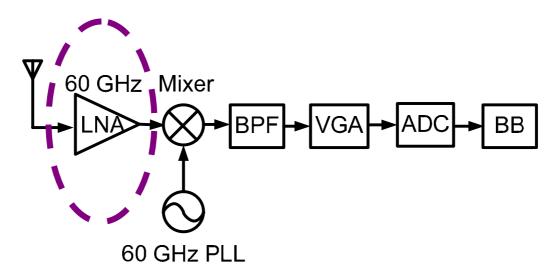
Investigation of the Parasitic Mutual Inductance of the Millimeter Wave Low Noise Amplifiers

李寧 岡田健一 松澤昭

東京工業大学大学院理工学研究科



- 60GHz帯に最大で9GHz幅の非常に広い帯域が、 免許なしで使用することができる。
- 60GHz帯を用いるとGbps単位の短距離高速無線 通信の実現が可能である。
- 高周波では、寄生素子の影響が顕著である。



60GHz受信機のアーキテクチャ

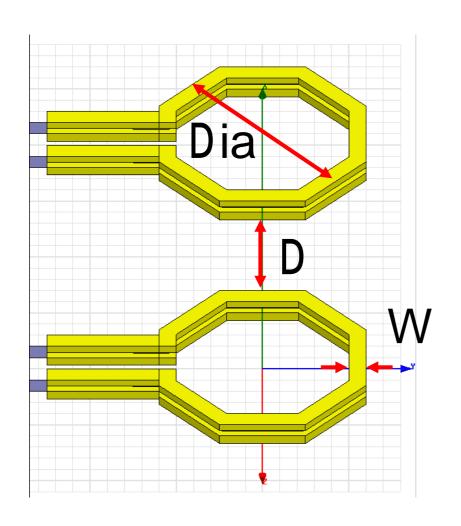


本研究の目的と内容

- 寄生相互インダクタンスの結合係数とインダクタ間の距離の関係を検討する。
- ミリ波用LNA における寄生相互インダクタンスの影響をシミュレーションにより求める。

シミュレーションの条件





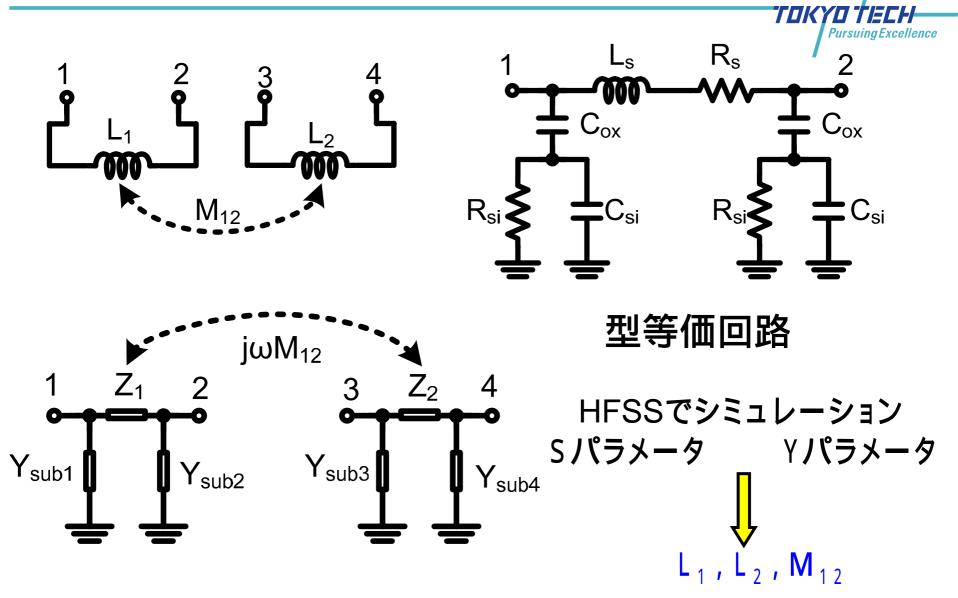
二つのインダクタンスの距離、 外径と線幅を変更して、 HFSSでシミュレーションした。

Dia:外径

D:距離

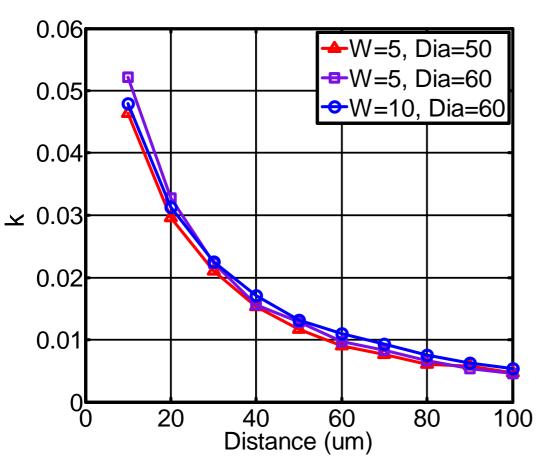
W:線幅





シミュレーションの結果





W:インダクタの線幅

Dia:インダクタの外径

$$k = \frac{M_{12}}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

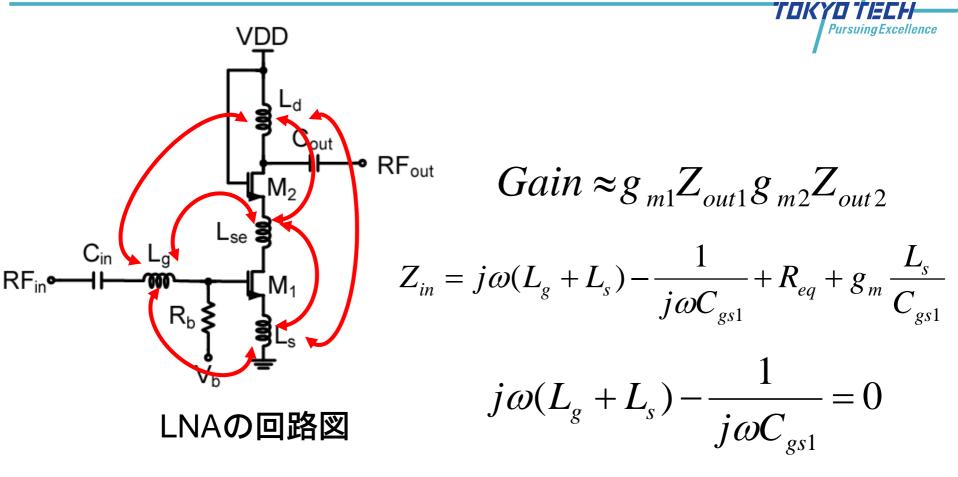
0.005 < k < 0.05

寄生相互インダクタンスの結合係数とインダクタ間の距離の関係。

90 nm CMOS プロセス



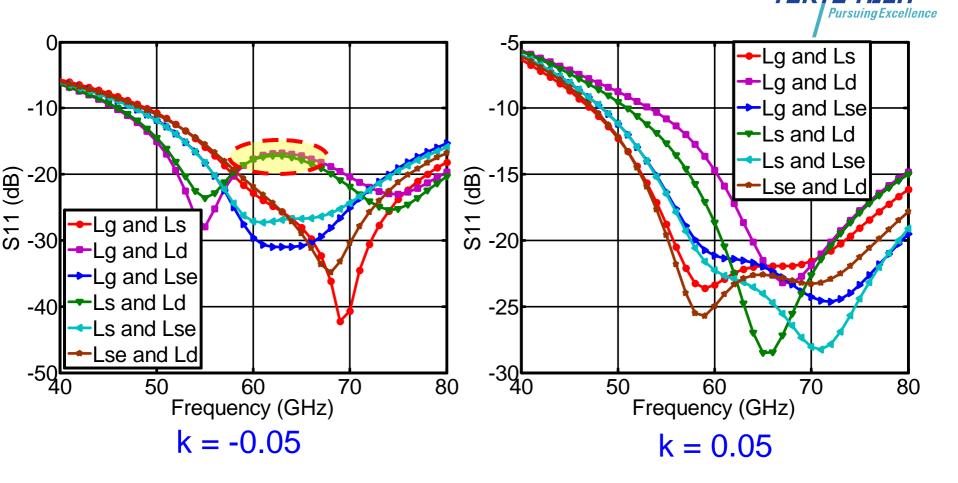
ミリ波用LNA における寄生相互インダクタンスの影響



 $L_{\rm g}$ と $L_{\rm s}$: 入力マッチング $L_{\rm se}$: 中間ノードのインピーダンス補償用 $R_{eq} + g_{m1} \frac{L_{s}}{C} = 50$ La:負荷

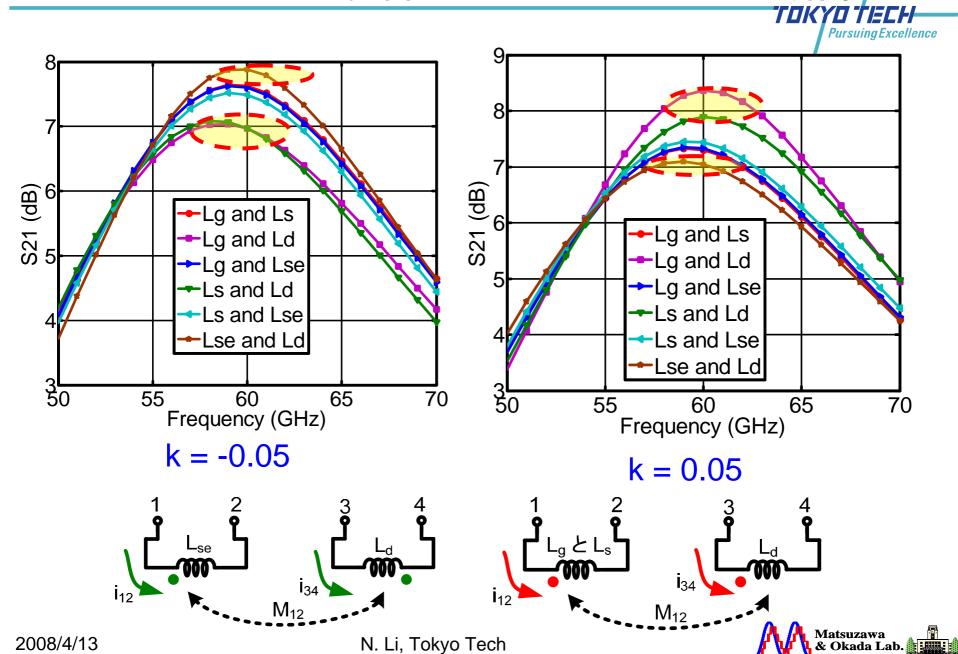


インダクタンスの影響のシミュレーションの結果

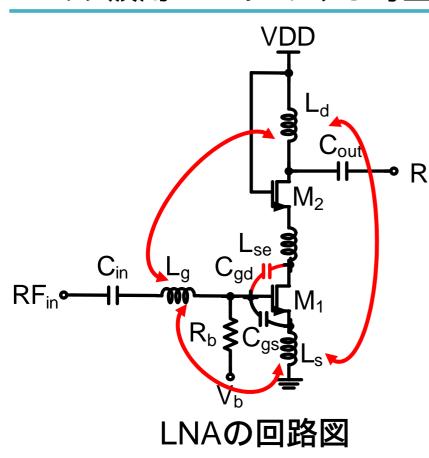


L_gとL_d、L_sとL_dの間の相互インダクタンスが負であることによって S₁₁ は劣化。

インダクタンスの影響のシミュレーションの結果



ミリ波用LNA における寄生相互インダクタンスの影響



90 nm CMOS プロセス

$$j\omega(L_g + L_s) - \frac{1}{j\omega C_{gs}} = 0$$

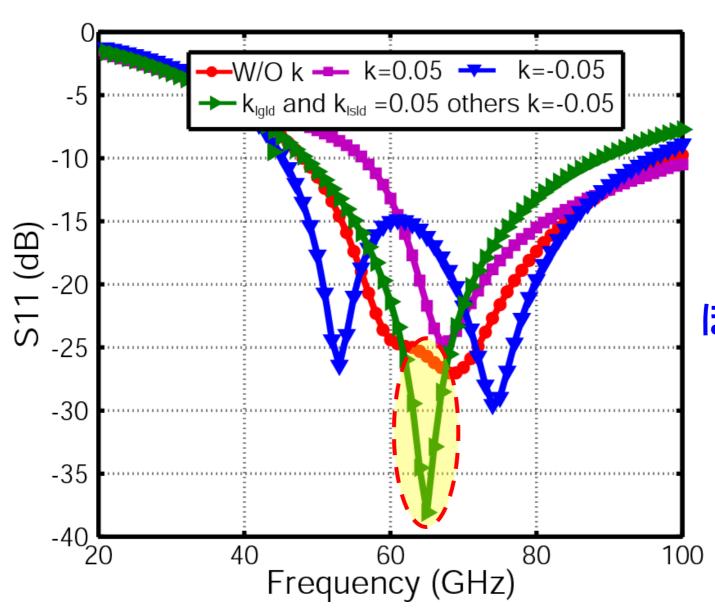
$$R_{eq} + g_m \frac{L_s}{C_{gs}} = 50$$

 $Gain \approx g_{m1}Z_{out1}g_{m2}Z_{out2}$

 $L_{\rm g}$ と $L_{\rm s}$: 入力マッチング $L_{\rm se}$: 中間ノードのインピーダンス補償用

La:負荷

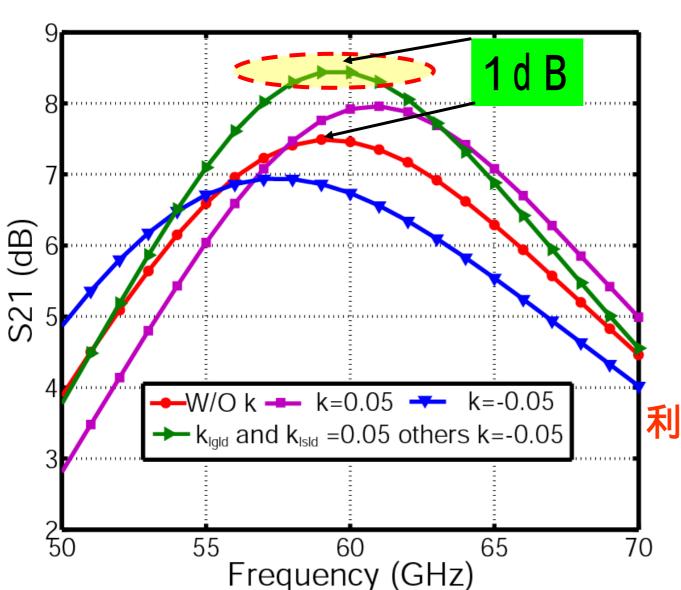
Pursuing Excellence



 k_{LgLd} =0.05 k_{LsLd} =0.05

ほかには-0.05

Pursuing Excellence



 k_{LgLd} =0.05 k_{LsLd} =0.05

ほかには-0.05

利得が1dB上がる

まとめ

- インダクタンスを用いたミリ波用LNAについて、寄生相互インダクタンスの影響を検討した。
- 寄生相互インダクタンスにより、入力マッチングと利得が劣化することがある。
- 相互インダクタをうまく利用することで、 性能を改善できる場合があることを示した。